

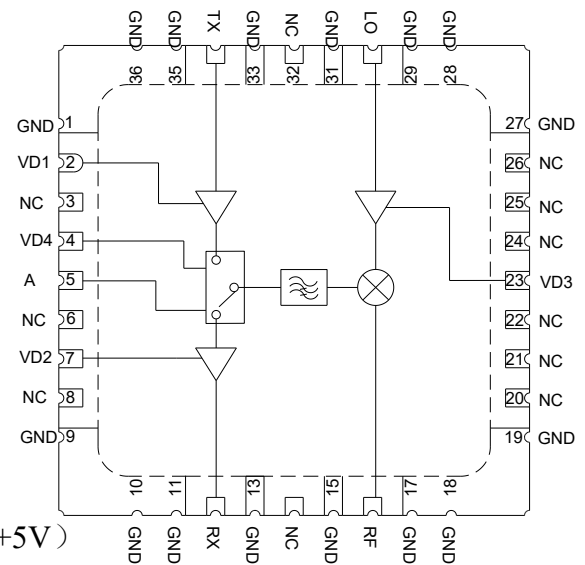
产品介绍

YSIP03-0626A2C 是一款采用陶瓷管壳封装的收发变频多功能。内部集成了本振放大器，中频放大器，低通滤波器，混频器，开关。射频频率覆盖 6GHz~26GHz，本振频率覆盖 6GHz~26GHz，中频频率范围为 0.5-6GHz，接收变频增益为 7dB，发射变频增益为 7dB，收发端口采用 0/+5V 逻辑控制。

关键技术指标

- 射频频率范围：6-26GHz
- 本振频率范围：6-26GHz
- 中频频率范围：0.5-6GHz
- 接收变频增益：7dB
- 发射变频增益：7dB
- 接收态射频输出1dB压缩功率：12dBm
- 发射态射频输出1dB压缩功率：2dBm
- 封装尺寸：7.80 mm × 7.80mm × 1.65mm

功能框图



电性能表 (T_A=+25℃, LO=-6dBm, VD1=VD2=VD3=VD4=+5V)

参数名称		符号	最小值	典型值	最大值	单位	
射频频率		RF Freq	6-26			GHz	
本振频率		LO Freq	6-26			GHz	
中频频率		IF Freq	0.5-6			GHz	
接收通道	变频增益	Conversion Gain	5	7	—	dB	
	LO-RF隔离度	LO-RF ISO	—	35	—	dB	
	LO-IF隔离度	LO-IF ISO	—	20	—	dB	
	RF-IF隔离度	RF-IF ISO	—	45	—	dB	
	射频输出1dB压缩功率		OP1dB	12	13	—	dBm
	回波损耗	RL-RF	RL	5	10	—	dB
RL-IF		7		8	—	dB	
RL-LO		7		15	—	dB	
发射通道	变频增益	HLO=24GHz	1.5	5	—	dB	
		LLO=6GHz	4	7	—	dB	
		LLO=12GHz	1.5	4.5	—	dB	
		LLO=18GHz	1.2	5	—	dB	
	LO-IF隔离度	LO-IF ISO	—	45	—	dB	
射频输出1dB	HLO=24GHz	—	0	1.5	2.5	dBm	

	压缩功率	LLO=6GHz	—	0	2	2.5	dBm	
		LLO=12GHz		0	1	1.5	dBm	
		LLO=18GHz		0.5	1.5	2	dBm	
	射频回波损耗	HLO=24GHz	RL_RF		7	8	—	dB
		LLO=6GHz			5	6	—	dB
		LLO=12GHz			4.5	5	—	dB
		LLO=18GHz			8	15	—	dB
	中频回波损耗	HLO=24GHz	RL_IF		8	15	—	dB
		LLO=6GHz			8	15	—	dB
		LLO=12GHz			8	15	—	dB
		LLO=18GHz			8	12	—	dB
	工作电压			VD	—	5	—	V
总电流			ID	—	155	—	mA	

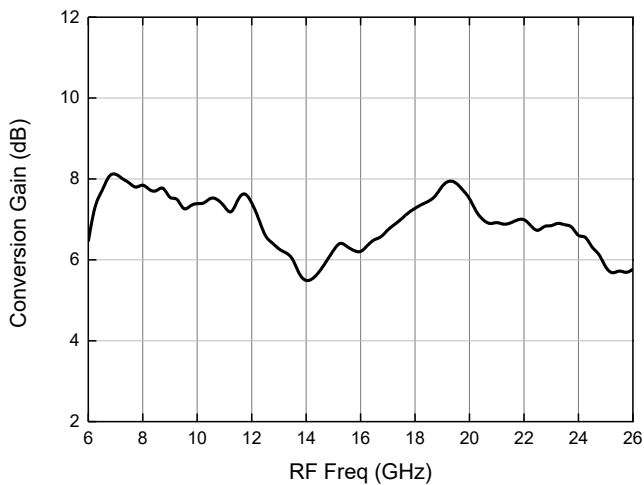
使用限制参数

射频最高输入功率	+18dBm
本振最高输入功率	+18dBm
中频最高输入功率	+18dBm
建议本振功率范围	-8dBm~-5dBm
正电源电压极限值	+6V
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C~+125°C

测试曲线 (T_A=+25°C, LO=-6dBm, VD1=VD2=VD3=VD4=+5V)

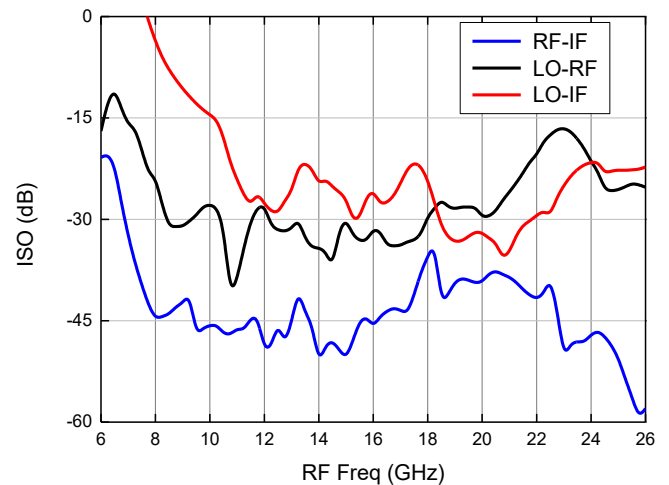
接收状态 (IF=500MHz)

变频增益

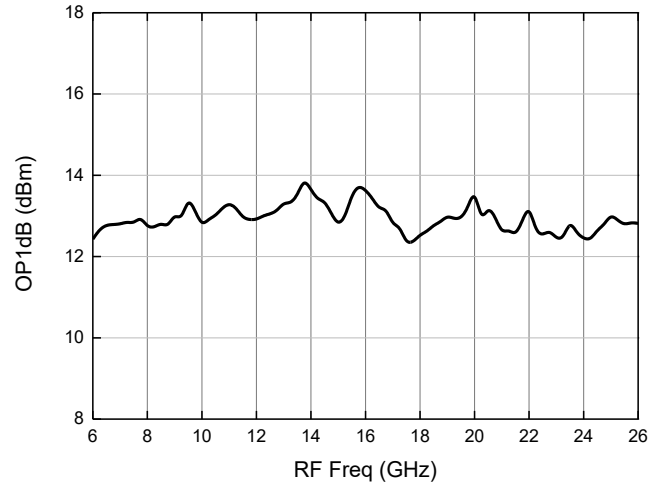
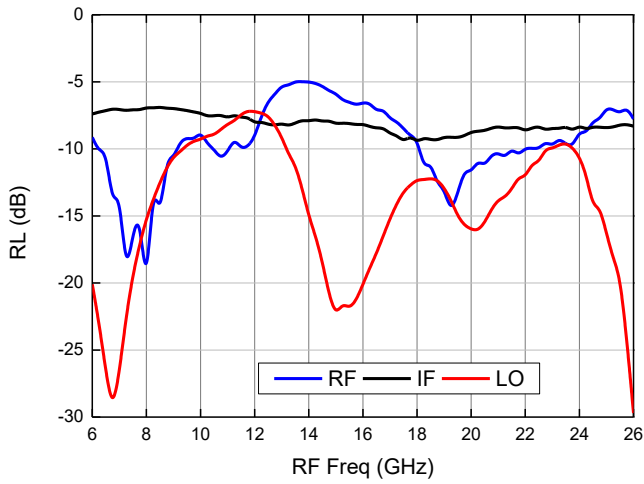


回波损耗

隔离度

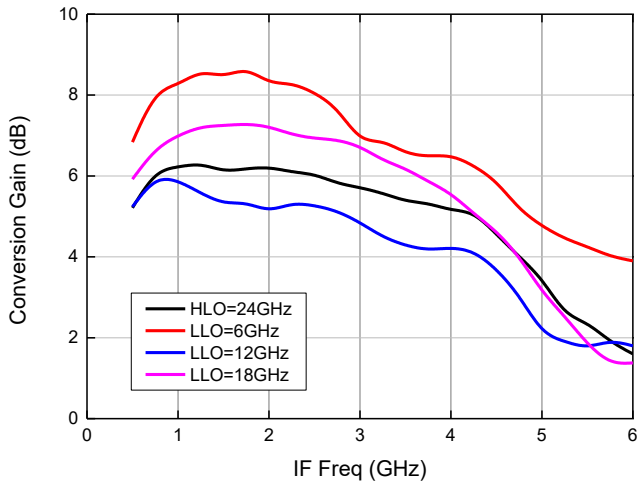


输出1dB压缩功率

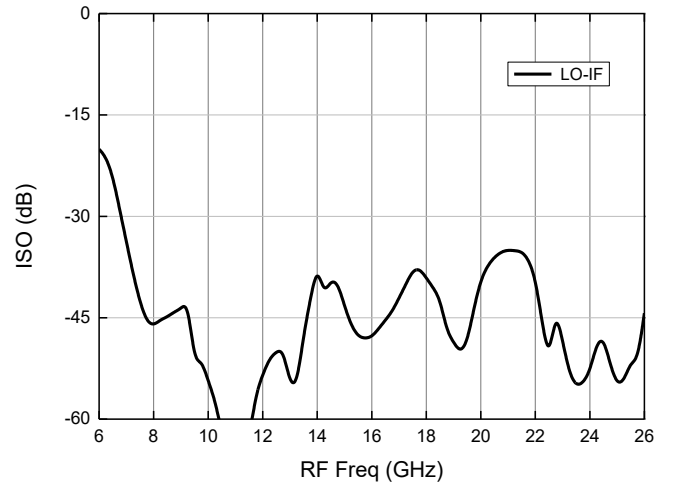


发射状态

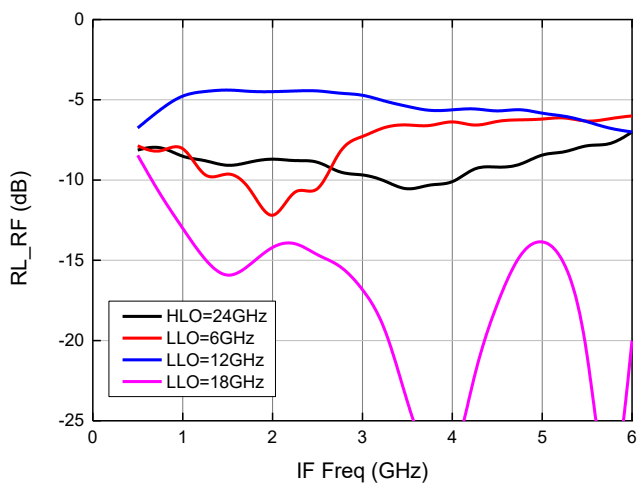
变频增益



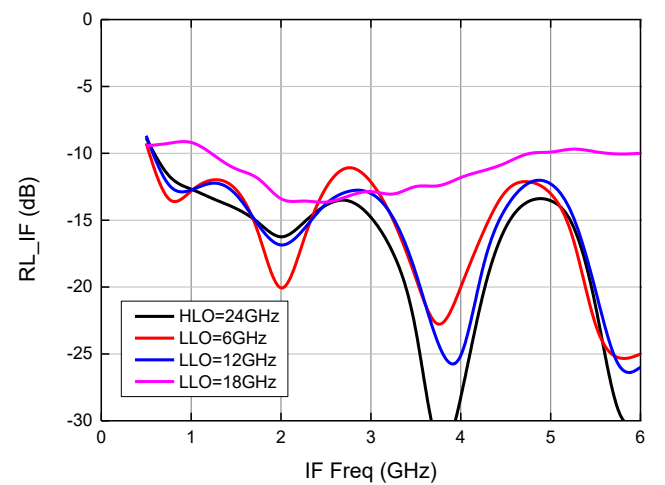
隔离度



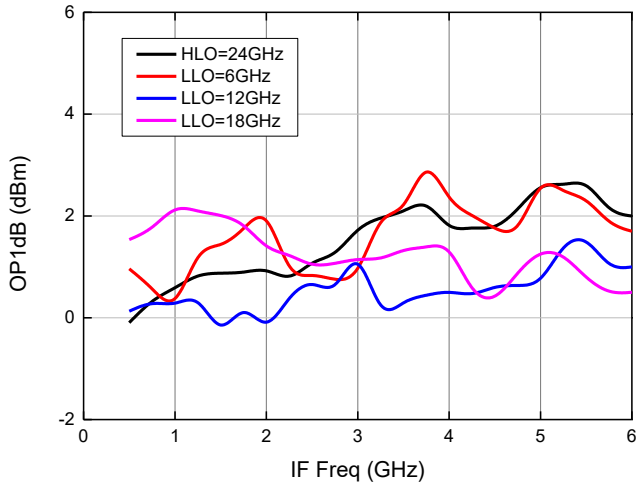
射频回波损耗



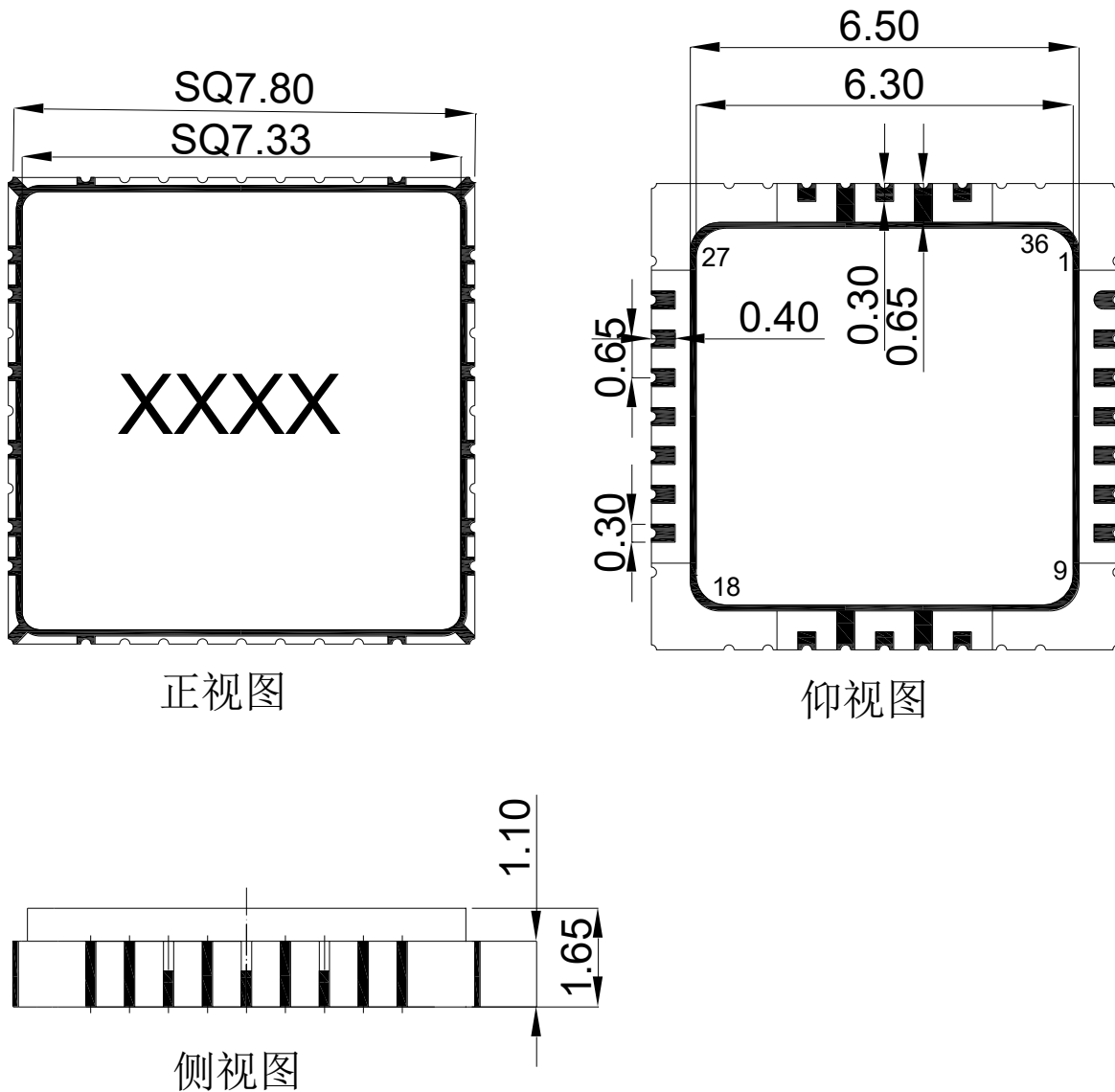
中频回波损耗



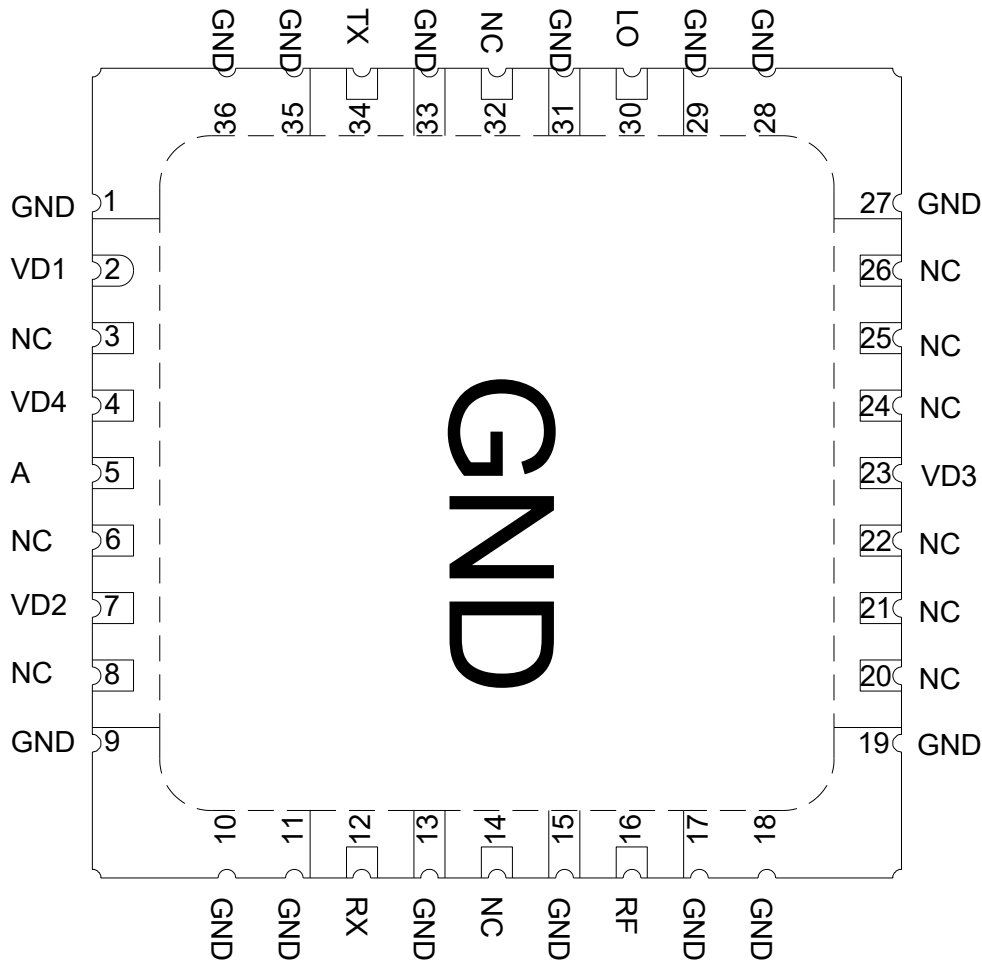
输出1dB压缩功率



外形结构图 (单位: mm)



端口图



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
30	LO	本振输入	RF
2	VD1	发射中频放大器供电	+5V
34	TX	发射中频输入	RF
4	VD4	开关供电	+5V
5	A	开关控制	0 or 3.3/5V
12	RX	接收中频输出	RF
7	VD2	接收中频放大器供电	+5V
16	RF	射频	RF
23	VD3	本振放大器供电	+5V
其它	NC	悬空, 建议接地	/
散热焊盘	GND	接地	/

接收发射真值表

工作模式	A*
TX	1
RX	0

*1 为高电平，电压范围为+3~+5V；0 为低电平，电压范围为 0~+0.5V

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) 封体材料：符合 RoHS 规范的陶瓷材料；
- 3) 产品适用于回流焊贴装工艺，回流焊温度 $\leq 260^{\circ}\text{C}$ ，回流焊使用时需要做去金预处理；
- 4) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时要注意防静电；
- 5) 干燥、氮气环境储存；
- 6) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。